# Моделирование напряженно-деформированного состояния в тонких структурированных пленках нитрида галлия на сапфировых подложках

© И.Н. Ивукин<sup>1,2</sup>, Д.М. Артемьев<sup>1,2</sup>, В.Е. Бугров<sup>1,2</sup>, М.А. Одноблюдов<sup>1</sup>, А.Е. Романов<sup>1-3</sup>

<sup>1</sup> Группа компаний "Оптоган",

Санкт-Петербург, Россия

07

<sup>2</sup> Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия

<sup>3</sup> Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: ivan.ivukin@optogan.com

(Поступила в Редакцию 16 апреля 2012 г.)

Представлены результаты моделирования напряженно-деформированного состояния в тонких структурированных пленках нитрида галлия на сапфировых подложках, содержащих открытые поры. Результаты получены методом конечных элементов в коммерческом программном комплексе. Вычислен коэффициент интенсивности напряжений *K*<sub>1</sub> для модели, рассматривающей трещину на границе GaN/сапфир вблизи открытой поры. На основании расчетов упругих полей получена оценка перераспределения напряжений структурой с упорядоченным массивом открытых пор в пленках нитрида галлия.

Работа выполнена при поддержке гранта № РФФИ 12-08-00397-а и проекта Мари Кюри PIIF2-GA-2008-908419.

## 1. Введение

Подложки на основе структуры GaN/сапфир — это неотъемлемая часть многих современных полупроводниковых устройств, таких, например, как светоизлучающие диоды. Значительное различие коэффициентов температурного расширения нитрида галлия и сапфира приводит к высокому уровню механических напряжений в слоях подложки. Наличие высоких механических напряжений наряду с дефектами кристаллической структуры может быть причиной образования трещин, которые распространяются внутри светодиодов и значительно уменьшают их эффективность [1].

Формирование упорядоченной пористой структуры в пленках нитрида галлия на границе GaN/сапфир используется для уменьшения уровня механических напряжений. Существует ряд методов выращивания нитридных полупроводников с формированием различных пористых структур [1-4]. Однако в большинстве подобных работ акцент делается на уменьшение плотности проникающих дислокаций и лишь в некоторых изучается влияние пористой структуры на уровень механических напряжений. Основная технология формирования таких структур — заращивание нитрида галлия с наноколоннами или вытравленными отверстиями [2,3,5]. В настоящей работе геометрия пор выбрана согласно результатам [5], где был рассмотрен практический способ создания упорядоченной пористой структуры. Метод, обсуждаемый в [5], описывает формирование периодического массива пор в слое нитрида галлия на сапфировом основании с использованием травления через маску. Преимуществами метода являются упорядоченность структуры и простота контроля геометрических параметров пор.

Целью настоящей работы является анализ зависимости термических напряжений от геометрических параметров пористой структуры в пленке нитрида галлия, оценка влияния пористой структуры на возможность зарождения трещин на границе GaN/сапфир, а также вычисление коэффициентов интенсивности напряжений  $K_I$ при зарождении трещин различного размера в окрестности открытых пор на интерфейсе GaN/сапфир.

## 2. Описание модели

Для численного моделирования напряженно-деформированного состояния в подложках GaN/сапфир с пористыми структурами был выбран программный комплекс COMSOL, использующий метод конечных элементов. Была использована линейно-упругая модель с анизотропными свойствами материалов. [6]

2.1. Геометрия. На рис. 1 представлена геометрия модели: упорядоченный массив открытых пор в пленке нитрида галлия, расположенных в гексагональном порядке. На рисунке показаны основные геометрические параметры и кристаллографическая ориентация слоя нитрида галлия [0001].  $H_f$  — высота пленки нитрида галлия,  $H_s$  — высота сапфирового основания,  $L_1$  и  $L_2$  — соответственно ширина и длина расчетной области, R — радиус вписанной в шестиугольник окружности. Расчетная область представляет собой упорядоченный массив элементарных блоков в виде параллелепипедов с основаниями площадью  $d_1 \times d_2$  ( $d_2/d_1 = 3$ ). Таким



**Рис. 1.** Схема расчетной области для упорядоченной пористой структуры в пленке нитрида галлия на сапфировом основании с геометрическими параметрами, описаными в тексте.



**Рис. 2.** Схема трещины нормального раскрытия на границе GaN/сапфир. *а* — вид сбоку, *b* — вид сверху.



Рис. 3. Зависимость нормированного усредненного гидростатического напряжения от нормированного радиуса поры.

Упругие постоянные  $C_{ij}$  (GPa) и коэффициенты термического расширения  $\alpha_{ij}$  (10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup>)

Материал	<i>C</i> <sub>11</sub>	$C_{12}$	<i>C</i> <sub>13</sub>	<i>C</i> <sub>33</sub>	$C_{44}$	$\alpha_{11}$	$\alpha_{22}$	$\alpha_{33}$
Cапфир	497	163	116	501	147	7.5	7.5	8.5
GaN	367	135	103	405	95	5.59	5.59	3.17

образом, мы имеем дискретную геометрическую структуру, состоящую из блоков в количестве  $n_1$  и  $n_2$  по направлениям x и y соответственно.

На рис. 2 представлена модель с трещиной на границе GaN/сапфир в окрестности центральной поры.

Исходная геометрическая модель была разбита на конечные элементы неструктурированной тетраэдрической сеткой, которая имеет измельчение вблизи центральной поры, выделенной на рис. 3, для получения более гладких распределений напряжений. В расчетах с трещиной проводилось сгущение сетки в окрестности фронта трещины. Число конечных элементов в расчетах варьировалось в пределах 2–3.5 миллионов.

2.2. Свойства материала и нагрузки. Упругие модули материалов были взяты из работы [7] и представлены в таблице. Они находятся в доверительном интервале экспериментальных данных публикаций [8–10]. Была задана собственная деформация, соответствующая уменьшению температуры на 800 K, а в качестве граничных условий на двух смежных боковых гранях задано условие симметрии.

2.3. Порядок расчета. В конечно-элементном анализе мы использовали следующий набор геометрических параметров:

$$M = \frac{\Delta}{H_f}, \quad A = \frac{R}{H_f}, \quad \frac{H_s}{H_f} = \text{const} = 225, \qquad (1)$$

где A — нормированный радиус вписанной в шестиугольник поры окружности, M — нормированный шаг пористой структуры,  $\Delta = d_1 - R$ . Расчеты проводились для различных значений этих параметров. Отношение высот  $H_s/H_f$  было выбрано таким, чтобы соответствовать реальной конфигурации пор [5].

В качестве представительной величины было выбрано нормированное гидростатическое напряжение

$$\frac{\operatorname{tr}(\sigma)}{\operatorname{tr}_{\operatorname{pl}}(\sigma)} = \frac{(\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz})}{(\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz})_{\operatorname{pl}}}$$
(2)

ввиду инвариантности при изменении системы координат и прямого отношения к биаксиальным напряжениям в беспористой (pl) тонкой пленке нитрида галлия на сапфировом основании. Также в рамках настоящей работы была рассмотрена компонента напряжений  $\sigma_{zz}$ . Все нормализирующие величины были взяты из расчета беспористой структуры подобного размера. Для количественной оценки напряженно-деформированного состояния проводилось усреднение нормализованного

гидростатического напряжения в объеме вокруг поры, выделенном на вставке к рис. 3.

В случае дискообразной трещины нормального раскрытия в полярной системе координат существует следующая асимптотическая формула [11] для коэффициента интенсивности напряжений:

$$K_{I} = \lim_{r \to r_{0} \to 0} \left( [2\pi(r - r_{0})]^{\frac{1}{2}} \sigma_{zz}(r, \theta, 0) \right).$$
(3)

Для получения зависимости  $K_I$  от длины трещины проводились расчеты для указанной выше постановки задачи с внесением в геометрию центральной поры радиальной дискообразной трещины (рис. 2). Нашей целью было получение нижней оценки  $K_I$ . Для этого сначала находилось направление, характеризующееся углом  $\theta_0$ , при котором значения  $\sigma_{zz}$  в окрестности фронта трещины минимальны. Затем полученное распределение  $\sigma_{zz}$ в направлении радиуса  $r_0$  вблизи фронта трещины аппроксимировалось функцией вида  $\sigma_{zz}(r, \theta_0, 0) = \frac{A}{\sqrt{r-r_0}}$ , находилась константа A и по формуле (3) вычислялось значение  $K_I$  для текущей длины трещины.

# 3. Результаты и обсуждение

Исследовалась зависимость нормированного усредненного гидростатического напряжения от нормированного радиуса поры с фиксированным шагом M = 1.35, выбранным в соответствии с указанным в работе [5]. Эта зависимость представлена на рис. 3. Видно, что соотношение между нормированным радиусом поры и нормированным усредненным гидростатическим напряжением



**Рис. 4.** Распределение нормированного гидростатического напряжения для открытых пор с нормированной высотой A = 0.3и 0.95 и шагом M = 1.35 в плоскости симметрии. Контур 11 в поле рисунка не подписан ввиду его малого размера.



**Рис. 5.** Распределение компоненты напряжений  $\sigma_{zz}$  для открытых пор с нормированной высотой A = 0.3 и 0.95 и шагом M = 1.35 в плоскости симметрии.



**Рис. 6.** Распределение компоненты напряжений  $\sigma_{zz}$  вдоль линий, параллельных границе GaN/сапфир (см. схему на вставке), на разном расстоянии от этой границы.

в пленке нитрида галлия и сапфировом основании имеет практически линейный характер. Угловой коэффициент для нитрида галлия равен -0.27.



**Рис. 7.** Зависимость  $K_I$  на границе GaN/сапфир от доли длины трещины в материале, отнесенной к минимальному расстоянию между порами  $d_0$ .

Распределения нормированного усредненного гидростатического напряжения для моделей с M = 1.35 и A = 0.3, 0.95 показаны на рис. 4. Из результатов, показанных на рис. 4, видно, что открытые поры приводят к уменьшению гидростатических напряжений в их окрестности. Напряжения концентрируются на границе поры и слоя нитрида галлия. Эффект локализации напряжений усиливается с увеличением нормированного радиуса пор.

Из рис. 5 видно наличие растягивающих напряжений  $\sigma_{zz}$  на границе GaN/сапфир, что может способствовать формированию трещин нормального раскрытия в этой области. Кроме того, значения  $\sigma_{zz}$  на границе GaN/сапфир повышаются с увеличением нормированного радиуса пор.

Из рис. 6 очевидно, что компонента напряжений  $\sigma_{zz}$  на границе GaN/сапфир достаточно быстро (менее чем на четверти высоты поры) сменяется растягивающим напряжением в пленке нитрида галлия.

На рис. 7 представлена полученная зависимость  $K_I$  от длины трещины. На границе GaN/сапфир вблизи поры складываются условия для возможного распространения трещины размером не менее трети ширины перегородки между порами. Это в конечном счете может привести к отделению подложки от пленки.

# 4. Заключение

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.

1. Исследуемая пористая структура характеризуется более чем 20% падением гидростатических напряжений в пленке нитрида галлия.

2. Увеличение нормированного радиуса пор обусловливает уменьшение усредненного гидростатического напряжения в пленке нитрида галлия.

3. Эффект локализации напряжений усиливается с увеличением нормированного радиуса открытых пор.

4. Возможно зарождение трещин на границе GaN/ сапфир и последующее отделение сапфировой подложки при повторном нагревании структуры.

Можно заключить, что рассмотренная пористая структура способна уменьшать механические напряжения в подложках GaN/canфир.

### Список литературы

- J.-M. Bethoux, P. Vennegues, F. Natali, E. Feltin, O. Tottereau, G. Nataf, P. De Mierry, F. Semond. J. Appl. Phys. 94, 6499 (2003).
- [2] Y.-S. Chen, W.-Y. Shiao, T.-Y. Tang, W.-M. Chang, C.-H. Liao, C.-H. Lin, K.-C. Shen, C.C. Yang, M.-C. Hsu, J.-H. Yeh, T.-C. Hsu, J. Appl. Phys. **106**, 023 521 (2009).
- [3] T. Gehrke. J. Nanophotonics 2, 021 990 (2008).
- [4] D.-S. Wuu, H.-W. Wu, S.-T. Chen, T.-Y. Tsai, X. Zheng, R.-H. Horng. J. Cryst. Growth 311, 3063 (2009).
- [5] M. Ali, A.E. Romanov, S. Suihkonen, O. Svensk, P.T. Torma, M. Sopanen, H. Lipsanen, M.A. Odnoblyudov, V.E. Bougrov. J. Cryst. Growth **315**, 188 (2010).
- [6] Н.А. Берт, А.Л. Колесникова, И.К. Королев, А.Е. Романов, А.Б. Фрейдин, В.В. Чалдышев, Е.С. Aifantis. ФТТ 53, 1986 (2011).
- [7] F. Wright. J. Appl. Phys. 82, 2833 (1997).
- [8] A.E. Romanov, T.J. Baker, S. Nakamura, J.S. Speck. J. Appl. Phys. 100, 023 522 (2006).
- [9] W. Qian, M. Skowronski, G.R. Rohrer. In: III-nitride, SiC, and diamond materials for electronic devices. Mater. Res. Soc. Symp. Proc. / Eds D.K. Gaskill, C.D. Brandt, R.J. Nemanich. Pittsburgh, PA (1996). V. 423. P. 475.
- [10] A. Polian, M. Grimsditch, I. Grzegory. J. Appl. Phys. 79, 3343 (1996).
- [11] Г.П. Черепанов. Механика разрушения композитных материалов. Наука, М. (1983). 296 с.